

# 测试题

## 填空题 (2\*20)

- 表面组装技术是指：\_\_\_\_\_。
- SMT 技术的优点有：\_\_\_\_\_。
- SMT 一般线体设备布局是：\_\_\_\_\_。
- 西门子贴片机属于（国家）：\_\_\_\_\_， NXT 贴片机属于：\_\_\_\_\_。
- 当前 SMT 表面组装双面面锡膏工艺流程顺序：\_\_\_\_\_。
- 智能制造 SMT 技术能制造自己用过的产品，列举四种以上：\_\_\_\_\_。
- 涂覆材料锡膏的重要特性：\_\_\_\_\_。
- 对以下单位进行换算  
 $30\text{H} = \text{_____ nH} = \text{_____ pH}$       $5 \times 10^3 \text{nf} = \text{_____ uf} = \text{_____ mf}$
- 英制转化为公制：  
 0805 的电子物料尺寸为：\_\_\_\_\_， 0201 电子物料尺寸：\_\_\_\_\_。
- 电阻表面字符 645 电阻值：\_\_\_\_\_， 色环电阻：橙棕紫灰电阻值：\_\_\_\_\_。
- 305 无铅焊料锡膏百分比比例分别是\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_、\_\_\_\_\_。
- 贴片技术中常见的缺陷有哪些：\_\_\_\_\_。
- 贴片机分类：\_\_\_\_\_。
- 贴片的质量要求有：\_\_\_\_\_。
- 四边无引脚扁平封装：\_\_\_\_\_， PLCC：\_\_\_\_\_。
- 焊接技术的重要性表现为：\_\_\_\_\_。
- 在焊接技术中，焊接方有：\_\_\_\_\_。
- 常用有铅锡膏的熔点：\_\_\_\_\_， 无铅锡膏的熔点：\_\_\_\_\_。
- 回流焊温区的分布为：\_\_\_\_\_。
- 金属模板（钢网）制造方法：\_\_\_\_\_。

## 二、简答题 (60)

- 当前智能制造 SMT 及时中常用的双面工艺是怎么样的，并详细写出这种工艺所使用的工艺顺序？ (6)
- SMT 中使用的焊接材料有哪些要求？ (6)
- 3、
- 一般贴片机的结构可分为哪些，并写出个部位的作用。(10)

5、写出 DEK 印刷机内部结构与之相对应的印刷参数。(8)

7、常见的制程缺陷分析方法鱼骨图法是从哪几个方面来分析制程中出现的缺陷？并使用鱼骨图试分析 SMT 技术中出现的偏位情况。(10)

6、试绘制出无铅锡膏的标准回流焊曲线？（注：标明升温速率机时间）（10）

8、.试分析近两年的中美贸易冲突，或者说中美贸易战争对于我们会有什么样的影响。(10)